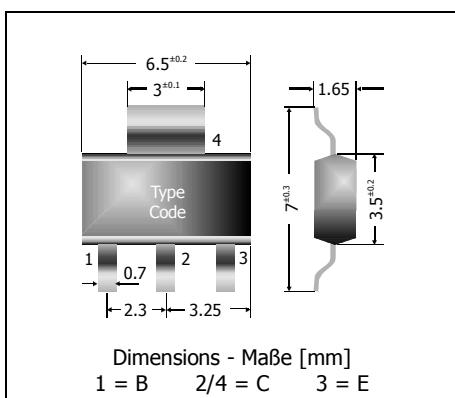


## BCP51 ... BCP53

**PNP**
**Surface Mount General Purpose Si-Epi-Planar Transistors**  
**Si-Epi-Planar Universaltransistoren für die Oberflächenmontage**
**PNP**

Version 2006-06-26



Power dissipation

1.3 W

Plastic case  
Kunststoffgehäuse

SOT-223

Weight approx.  
Gewicht ca.

0.04 g

Plastic material has UL classification 94V-0  
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging taped and reeled  
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle

### Maximum ratings ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

			<b>BCP51</b>	<b>BCP52</b>	<b>BCP53</b>
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- $V_{CEO}$	45 V	60 V	80 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	- $V_{CBO}$	45 V	60 V	100 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	C open	- $V_{EBO}$		5 V	
Power dissipation – Verlustleistung		$P_{tot}$		1.3 W <sup>1)</sup>	
Collector current – Kollektorstrom (dc)		- $I_C$		1 A	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- $I_{CM}$		1.5 A	
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		- $I_{BM}$		200 mA	
Junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_j$ $T_s$			-55...+150°C -55...+150°C	

### Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

### Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

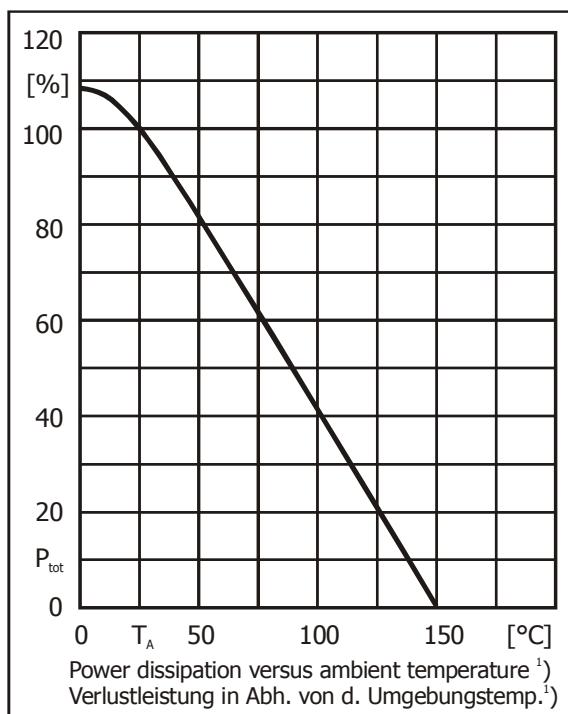
			<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>2)</sup>					
- $V_{CE} = 2 \text{ V}$ , - $I_C = 5 \text{ mA}$	all groups	$h_{FE}$	25		
- $V_{CE} = 2 \text{ V}$ , - $I_C = 150 \text{ mA}$	Group -6 Group -10 Group -16	$h_{FE}$ $h_{FE}$ $h_{FE}$	40 63 100	– – –	100 160 250
- $V_{CE} = 2 \text{ V}$ , - $I_C = 500 \text{ mA}$	all groups	$h_{FE}$	25	–	–
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. <sup>2)</sup>					
- $I_C = 500 \text{ mA}$ , - $I_B = 50 \text{ mA}$		- $V_{CEsat}$	–	–	0.5 V
Base-Emitter voltage – Basis-Emitter-Spannung <sup>2)</sup>					
- $I_C = 500 \text{ mA}$ , - $I_B = 50 \text{ mA}$		- $V_{BE}$	–	–	1 V

1 Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt pad) an jedem Anschluss

2 Tested with pulses  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

**Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )**
**Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )**

		<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom				
- $V_{CB} = 30 \text{ V}$ , (E open)	- $I_{CBO}$	–	–	100 nA
- $V_{CB} = 30 \text{ V}$ , $T_j = 125^\circ\text{C}$ , (E open)	- $I_{CBO}$	–	–	10 $\mu\text{A}$
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom				
- $V_{EB} = 5 \text{ V}$ , (C open)	- $I_{EBO}$	–	–	100 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz				
- $V_{CE} = 5 \text{ V}$ , $-I_C = 10 \text{ mA}$ , $f = 100 \text{ MHz}$	$f_T$	–	120 MHz	–
DC current gain ratio of the complementary pairs Verhältnis der Stromverstärkungen komplementärer Paare				
$ I_C  = 150 \text{ mA}$ , $ V_{CE}  = 2 \text{ V}$	$h_{FE1}/h_{FE2}$	–	–	1.6
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft	$R_{thA}$	< 93 K/W <sup>1)</sup>		
Thermal resistance junction to soldering point Wärmewiderstand Sperrsicht – Lötpad	$R_{thS}$	< 27 K/W		
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren		BCP54 ... BCP56		



<sup>1</sup> Mounted on P.C. board with  $3 \text{ mm}^2$  copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit  $3 \text{ mm}^2$  Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss